

T-870A-AC110V

BGA 紅外拆焊返修台

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



產品特點

- 1 機器採用自主研发的紅外線發熱器件、國際先進的紅外線拆焊技術
- 2 專用紅外線加熱穿透力強器件受熱均勻，突破傳統熱風拆焊機罩住元件加熱，熱衝擊較大缺點
- 3 操作容易無需拆焊治具，本機可拆焊 35-50mm 所有元件
- 4 本機配備 800W 預熱溶膠系統，預熱範圍 240x180mm
- 5 紅外線加熱無熱風流動，不會影響周邊微小元件，可拆焊或返修 BGA、SMD、CSP、LGA、QFP、PLCC 和 BGA 植球，尤其是 BGA、SMD 元件。同時可以返修各種排插條和針式插座(如 CPU 插座和 GAP 插排)
- 6 完全能滿足電腦、筆記本、電遊等 BGA 拆焊/返修要求

主要參數

工作台面尺寸：360*240mm

額定電壓和頻率：AC220-230V~60/50Hz

整機功率：1000W

紅外燈體功率：150W

紅外預熱底盤功率：800W

紅外燈體加熱尺寸：Φ70mm (50*50mm)

預熱底盤預熱尺寸：240*180mm

紅外燈體溫度可調：200℃~350℃

預熱底盤溫度可調：60℃~200℃

內容物：焊台主體*1、紅外燈體*1、溫度傳感器*1、PCB 板托架*1、電源線*1、用戶使用手冊*1

1、開機和開機前檢查：

①、開機前先檢查紅外燈體、溫度傳感器及電源線是否連接好

②、打開電源開關。等自檢通過後再使用(面板顯示屏上顯示為上次使用時設定值)

③、前面板有兩個開關，分別控制 PCB 板預熱、紅外燈體工作；按動前面板“IR PRE-HEAT PLATE”的“▲”“▼”，可以在 60-200℃內，調節 PCB 板的預熱溫度，按動開關為“ON”，則預熱底盤開始工作，按動開關為“OFF”，則預熱底盤停止工作；按動前面板“IR HEAT LAMP”的“▲”“▼”，可以在 200-350℃內，調節紅外燈體的工作溫度，按動開關為“ON”，則紅外燈體開始工作，按動開關為“OFF”，則紅外燈體停止工作

2、拆焊/返修的操作：

①、PCB 板的放置：

將選好的將 PCB 闔對準托板上的槽口，放置在 PCB 板支架上，緊固 PCB 板托板手輪，固定好 PCB 板；左右移動托板滑架，選取合適的工作位置

②、拆焊/返修前的調整和準備工作：

調節 PCB 板位置，使需拆焊/返修的芯片中心垂直對準紅外燈體的光斑中心；調整燈體高度，保持燈頭與拆焊物件高度為 20-30mm 為宜；調節紅外燈溫度傳感器的高度，防止在芯片或芯片近旁適當的位置，在芯片的四周和傳感器頭塗上助焊劑（焊寶或焊油），這樣做可使傳感器測到的溫度更準確，同時有助焊劑的助焊作用，BGA 焊盤會更加完好，能有效防止焊盤被粘起和起錫毛等問題。當芯片塗有防水固封膠時，一定要先開啓紅外預熱底盤熔膠，讓膠受熱軟化或粉化後，先清理掉；也可用溶膠水溶膠等其他措施。按照廠家提供的溶膠溫度，進行溶膠處理，熔膠溫度不宜過高，一般為 120-140℃為宜，預熱時間為 3-5 分鐘或更長

③、拆焊/返修過程：

根據產品的工藝要求或 PCB 板的大小，調節 PCB 板的預熱溫度(60-200℃可調)，可以提前開啓預熱底盤，一般 3-5 分鐘，預熱底盤會穩定在預設的溫度範圍內；根據芯片的尺寸和焊接工藝要求，選取適當的紅外線燈的加熱溫度（200-450℃可調），能滿足拆焊/返修工藝要求即可。

一般經驗為：根據拆焊/返修芯片大小，適當調節紅外燈的輸出溫度(200-450℃可調)和 PCB 板預熱溫度(60-200℃可調)；拆焊/返修小於 20x20mm 的芯片時，可調節紅外燈溫度到 220-240℃左右，如果芯片沒塗防水固封膠，或 PCB 板較小不會變形，可不開預熱底盤預熱；否則先預熱到 100-120 度為宜；拆大於 30x30mm 芯片時，根據工藝和用戶經驗，可調節紅外燈到 240-260℃左右，預熱

底盤 PCB 板溫度到 120-140°C，先預熱 3-5 分鐘，等底盤穩定在預設的溫度後，可很方便完成拆焊/返修過程；紅外燈熱度可以無級調節，根據你選擇的芯片大小自由調節，當調節到最大時，紅外線光最強，芯片升溫較快，特別注意控制，防止傳感器移位，測溫不准，芯片受熱時間太長，升溫太高，熱壞芯片。

拆卸的操作過程一般為：固定 PCB 板、調整 PCB 板的位置、調節紅外燈的中心對正拆卸的芯片、調整紅外燈的高度、放置紅外燈的溫度傳感器、塗助焊劑、設定預熱底盤的預熱溫度和紅外燈的工作溫度、開啓預熱底盤、經 3-5 分或更長點，預熱溫度穩定在設定值附近、開啓紅外燈加熱芯片、達到預設溫度或芯片錫盤融化、用真空吸筆或鑷子取下芯片、關閉紅外燈和預熱盤開關、等主機充分冷卻後，關閉電源。

回焊的操作過程一般為：操作過程基本同拆卸過程。不同之處為：先清理焊盤和植錫球、預熱 PCB 板、正確放置芯片、按錫球回焊的工藝溫度進行預熱、回流焊接、冷卻。

對於無鉛器件可以再提高溫度 20-30°C 均可。

④、拆焊/返修各種排插條和針式插座（如 CPU 插座和 GAP 插排）：

一般操作為：先將要拆焊的 PCB 板怕熱的部分和不拆焊的器件用鋁箔紙罩住，再將要拆焊的 PCB 板固定在 PCB 板支架上，固定好，預設 PCB 板預熱溫度到 160-180°C，將溫度傳感器放置在拆焊器件旁邊，開啓預熱底盤、經 3-5 分或更長點，拆焊器件受熱均勻後，一般可以拆焊。特殊的可以開啓頂部紅外燈輔助加熱，可以快速拆焊器件。對於無鉛器件可以再提高溫度 20-30°C 均可。

對於雙面板，可以採用較低的預熱溫度先預熱 PCB 板，再輔以頂部加熱即可。

⑤、拆焊/返修過程中的注意事項及相關說明：

拆焊/返修比較大的 PCB 板的芯片時，比如：電腦板，一定要充分進行整板的預熱乾燥處理，可根據廠家提供的工藝要求進行，也可憑經驗處理；只有處理得當，才能有效防止拆焊/返修芯片時，PCB 板的變形和由此產生的虛焊、芯片翹角。

對於簡易封裝的芯片，建議在芯片的中心部分（矽片位置）預貼鋁箔紙，防止矽片過熱爆裂。鋁箔紙的尺寸為稍大於矽片為好，也不要太大，會影響芯片焊接效果的。

拆焊/返修過程中，紅外燈照射的區域內，所有的塑料插件，應用鋁箔紙進行覆蓋，防止高溫紅外線烘變形或損害。但不是全部包裹。

回焊/返修完的 PCB 板，等冷卻後先清洗、乾燥後，進行測試；如不行可再回焊一遍。再不行重複整個過程。

工作前後，在沒有按放 PCB 板的情況下不可長時間開啓紅外燈，會減少燈的使用壽命；嚴禁用紅外燈長時間照射反光性很強的反光物會嚴重影響燈的壽命。

3、保養和檢修：

①、整機體的保養：機器使用一段時間後，對調焦架、導柱、PCB 板支架等的滑動部分，定期用油脂擦拭，保持滑潤和防銹目的。

②、預熱底盤和紅外燈體保養：預熱底盤和紅外燈體，特別是紅外燈的高通透防護玻片，定期用無水酒精擦拭去除助焊劑冷凝物，以保持紅外線熱幅射的通暢。

③、紅外燈的更換：更換紅外燈時，用專用的內卡鉗或長嘴尖嘴鉗，先將固定玻片的彈簧內卡、玻片、彈簧內卡一次取下；再取下固定紅外燈的彈簧內卡，然後用竹籤或木棒在燈筒外的通風孔處，輕輕頂出紅外燈，拔出燈座更換新的紅外燈；按相反的順序再裝上即可。

注意事項：

- 1 工作完畢後不要立即關電源，使風扇充分冷卻燈體延長使用壽命
- 2 保持通風口通風暢通燈體潔淨。定期用無水酒精清潔燈頭玻片
- 3 導柱、調焦支架適時用油脂擦拭保持潤滑
- 4 小心高溫操作注意安全
- 5 長久不使用應拔去電源插頭

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)